Bispa®

http://bispa.co.jp/

■「BSC-8NSCOFA-CABLE」仕様書

＜主な製品仕様＞
・芯線仕様：溶融銀コート＋素純銅縒り線(※1)
・主線径：0.20mm(×7本)
・芯線皮膜材質：ポリエチレン(XLPE)
・芯線外径：1.20mm ± 0.10(×2/青・白)
・絶縁膜：ポリエステルアルミ箔
・ドレン線：錫メッキコート＋電気精錬銅(電気的仕様等はEU規格に準拠)
・外皮膜材料：Flexible PVC/Neoprene composite
・ケーブル径：3.5Φ±0.2mm

＜電気的な仕様＞
・芯線抵抗：80.2 (Ohm/km)
・ドレン線抵抗：80(Ohm/km)
・芯線-皮膜間容量：65.5(pF/m)
・シールド間容量：124.6(pF/m)

＜備考＞
・導体および絶縁材にはハロゲン化合物や鉛など有害な物質を含んでいません。(RoHS準拠)
・途中で切った線材は、芯線及びドレン線に「半田メッキ処理」を施して頂いた上で保存して頂けると、線材の品質を落とす事無く保存する事が可能です。
・こちらのケーブルには「方向性や指向性」は、特に無く気軽に御利用頂けるような処理を施しています。
・電気蒸着による芯素線の動イオン運動を防止する為、真空状態にて溶解メッキ処理を施しています。(薬剤や電気精錬による再処理を行っていない為、銀特有の黒化現象が生じる事があります。)

※1：芯素線の銅の純度は「99.999999%(8N)相当」となっております。これは、製造ラインそのものは「8N銅認可を得ている生産ライン」にて、純度の高い素銅を精錬・製造していますが、製品としての国際規格準拠の承認は取っていませんので、予め御了承下さい。